

中信证券股份有限公司
关于广东世运电路科技股份有限公司
变更部分募投项目及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就世运电路变更部分募投项目及部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目、募集资金投资项目延期的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 117,964,243 股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 179,305.65 万元，扣除承销及保荐费 1,393.06 万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费 400.00 万元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为 177,512.59 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 212.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 177,700.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8 号）。

（二）募集资金实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	累计已投入募集资金总额	募集资金余额	募集资金投入进度
1	鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）	116,899.81	109,700.23	8,184.88	101,515.35	7.46%
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,000.00	8,755.54	21,244.46	29.19%
3	补充流动资金	38,000.00	38,000.00	38,000.00	-	100.00%
合计		184,975.51	177,700.23	54,940.42	122,759.81	-

注 1：“募集资金承诺投资总额”为公司根据扣除发行费用后的实际募集资金净额调整后的拟使用募集资金投资金额。

注 2：“募集资金余额”为截至 2025 年 6 月 30 日数据，不包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准。

注 3：以上数据如有尾差为四舍五入所致。

（三）拟变更募集资金投资项目、募集资金投资项目延期的情况

1、原项目一拟变更及延期情况

根据公司发展战略和实际情况，公司拟将原项目一“鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）”尚未投入的部分募集资金 52,000.00 万元变更投向至新项目“泰国高峰绿色工业园新建年产 120 万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）”。同时，基于原项目一目前实际建设，剩余尚未投入的募集资金合计 49,515.35 万元将继续用于原项目一的投资建设。

同时，公司结合原项目一的实际建设情况和投资进度，将原项目一达到预定可使用状态日期由“2025 年 12 月”延长至“2027 年 6 月”。新项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 12 月。

2、原项目二延期情况

公司结合原项目二的实际建设情况和投资进度，将原项目二达到预定可使用状态日期由“2025 年 12 月”延长至“2026 年 12 月”。

上述原项目一、二调整前后的具体情况如下表列示：

单位：万元

变更前			
项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期
鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）	116,899.81	109,700.23	2025 年 12 月
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,000.00	2025 年 12 月
变更后			
项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期
鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）	62,895.03	57,700.23	2027 年 6 月
泰国高峰绿色工业园新建年产 120 万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）	112,649.78	52,000.00	2026 年 12 月
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,000.00	2026 年 12 月

新项目拟投入募集资金总额为 52,000.00 万元，占公司实际募集资金净额的 29.26%。本次变更募集资金投资项目及募投项目延期事项不构成关联交易。

二、变更部分募集资金投资项目、募集资金投资项目延期的具体原因

（一）原项目一计划投资和实际投资情况

原项目一“鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）”实施主体为广东世运电路科技股份有限公司，实施地点位于广东省江门市鹤山市共和镇世运路 8 号，项目总投资额为 116,899.81 万元，其中建筑工程费 550.00 万元，设备购置及安装费 110,679.95 万元，铺底流动资金 5,669.86 万元，建设周期 24 个月。项目达产后预计将实现年销售收入 160,560.00 万元（不含税），年均税后净利润 20,086.12 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金 8,184.88 万元，投入进度为 7.46%，尚未投入的募集资金余额为 101,515.35 万。为保障募投项目整体经济效益，公司根据战略布局调整及市场环境变化，已适度放缓原项目一投资进度。

（二）原项目一变更后的情况

1、项目名称：鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）

2、实施主体：广东世运电路科技股份有限公司

3、建设地点：鹤山市共和镇世运路 8 号

4、项目建设周期：本项目建设周期为 42 个月

5、项目建设内容：本项目总投资额为 62,895.03 万元，拟使用募集资金投资金额为 57,700.23 万元，具体的项目构成为：其中建筑工程费 550.00 万元，设备购置及安装费 58,870.81 万元，铺底流动资金 3,474.22 万元。项目通过引进国内外先进的印制电路板生产设备及配套设施，招聘高素质的技术、管理和生产人员，扩大公司 PCB 生产规模，提高生产效率，优化产品结构，从而进一步提升公司收入水平、增强盈利能力。项目建成后，公司将新增年产双面板、多层板及 HDI 板 70 万平方米的产能。

6、经济效益分析：经预测分析，项目达产年将实现销售收入 97,515.00 万元，净利润 12,085.43 万元。本项目财务内部收益率与投资回收期均处于正常水平，各项经济效益指标合理，均符合国家有关规定及投资方要求，在经济效益方面是切实可行的。

（三）原项目一变更具体原因

本次考虑变更部分原项目一募集资金投向新项目，主要基于公司战略布局调整及市场环境变化等因素，具体原因如下：

1、推进全球化战略

首先从产能布局来看，公司现有产能集中于国内，为更好地满足国际市场需求、深化全球化布局，提高客户的供应链安全系数，建设海外生产基地成为必要举措。其次从客户服务来看，新项目不仅能实现对国际客户的快速响应、提升海外客户服务质量，更有助于公司向“国内领先、国际一流的 PCB 行业领军企业”目标迈进。再次从技术资源来看，在海外建设生产基地有利于吸引海外高端 PCB 人才，提升公司 PCB 研发、生产技术。因此，目前对公司来说，建设海外生产基地的优先级较高。

2、产品升级转型需要

近年人工智能的发展推动了一系列上下游企业的技术升级,其中所需的 PCB 具有高密度及多层设计、高性能材料、精细制造工艺、优质的信号传输及散热等特性,这对 PCB 供应商的生产工艺以及供应链提出了更高的要求。加上国内市场竞争激烈,尤其是中低端市场,长期处于内卷状态。因此,为了适应市场发展需求,提升公司的核心竞争力,公司计划调整原项目一的产能规划,年产能由 150 万平方米下调至 70 万平方米,高多层、HDI 电路板占比增加。

(四) 原项目一、原项目二延期的具体原因及延期后保障措施

1、原项目一、原项目二延期的具体原因

为进一步优化资源配置、深化全球化战略布局,更好的满足国际市场需求,集中资源加速海外生产基地建设,经审慎研究后决定对原项目一、原项目二进行延期。

2、延期后保障项目按期完成的相关措施

公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况,根据公司战略及业务发展需要推进募集资金投资项目的实施进程,紧跟市场周期变化及时调整项目建设节奏合理规划产能,积极优化资源配置,增强项目各相关部门单位的协同性,有序推进项目后续的实施,保障募集资金投资项目按期完成。

三、新项目的具体内容

(一) 新项目基本情况

1、项目名称: 泰国高峰绿色工业园新建年产 120 万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目(一期)

2、实施主体: 泰国世运电路有限公司(Olympic Circuit (Thailand) Company Limited)(以下简称“泰国世运”)

3、建设地点: No. 915/38 Moo9, Hua Samrong Subdistrict, Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, 24190 Thailand

4、项目建设内容: 通过建设高规格的印制电路板生产车间,引进国内外先进的生产设备及配套实施,并派驻高素质生产、技术和管理人员,培训当地的人员技能。加强高多层电路板产能建设,扩大生产规模,进一步优化公司的产品结

构，提升产品的整体附加值，打造高端品牌形象，提升公司盈利能力。

（二）投资计划

新项目总投资额为 112,649.78 万元，拟使用募集资金投资金额为 52,000.00 万元，具体的项目构成为：其中土地购买投入 9,000 万元，工程建设投入 50,313.30 万元，设备购置及安装费 50,138.76 万元，铺底流动资金 3,197.72 万元。新项目建设周期为 24 个月，具体项目内容包括项目规划及前期准备、厂房建设及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、设备调试及验证、试运行。

四、新项目必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、降低潜在贸易摩擦风险，增强公司的抗风险能力

近年来，各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力增加，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给产业链带来的潜在风险不容忽视。未来如果国际贸易摩擦持续发生，导致相关国家对公司的产品提高关税、采取限制政策，或者公司的主要客户被有关国家列入出口管制清单中，或者相关国家采取其他贸易保护的相关措施，将给公司的生产经营带来不利影响。公司在海外布局生产基地，是公司保障海外供应链稳定的重要战略举措。

2、有利于通过产业布局，确保公司海外供应链的稳定

公司本次在海外投资建设生产基地是基于确保海外供应链稳定的整体战略布局。出口销售是公司营业收入的重要组成部分，公司在海外投资建厂，可以充分利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，持续强化与境内外客户业务交流，积极寻求新的战略合作，广泛开展技术交流与新产品的市场拓展，符合公司长期战略部署和股东利益。

3、有利于提升公司产能规模，满足海外市场发展需求

根据 Prismark 预测，2024 年至 2029 年间，全球 PCB 行业产值将以 5.2% 的年复合增长率增长，到 2029 年将达到 947 亿美元，在市场发展前景良好且产品需求强劲的情况下，在海外投资建设生产基地有利于提升公司产能，以满足海外市场的发展需求，进一步提升公司规模优势，拓展产品类型和提升行业地位。

（二）可行性分析

1、泰国东部经济 EEC 特区有政策支持为项目实施提供良好的外部条件

HDI 印制电路板属于泰国鼓励发展的高新技术产业，近年来，泰国多部委制定了一系列鼓励、促进行业发展的政策和法规。

2020 年以来，由于地缘政治升温，PCB 行业开始了第五次产能迁移，以泰国、越南、马来西亚为代表的东南亚国家成为本轮产能迁移的主要受益者。泰国更是以其政治环境稳定、劳动力资源丰富、产业链配套较完善等优势，成为新的 PCB 产业集聚地。

泰国投资委员会（BOI）发布的数据显示，2024 年，泰国 PCB 行业呈指数级增长。过去两年，PCB 行业投资项目超过 100 个，总价值逾 1,700 亿泰铢，其中大部分来自中国大陆、中国台湾和日本。公开资料显示，包括深南电路、景旺电子、崇达技术、生益电子、奥士康等大陆 PCB 厂商及臻鼎、欣兴、华通、沪电、金像、台耀和定颖等台湾省主要 PCB 制造商已在泰国投资生产高密度互连 PCB、柔性 PCB 和多层 PCB 等，以满足先进的人工智能和电子产品的需求。大多数工厂位于泰国巴真武里府、大城府和北榄府，预计将于 2025 年陆续投产。内资 PCB 厂商四会富仕、威尔高泰国工厂已于 2024 年投产，正处于调试设备逐步量产阶段。

2、深厚的技术与研发实力为项目实施提供保障

经过多年的研发投入及经验沉淀，公司开发了多项具有完全知识产权的技术和工艺方法，并设计了一套公司独有的多层板生产技术体系。近年来，公司开拓高频、高速、高层、高阶 PCB 业务取得进展，云端数据中心、AI 大算力模组、边缘计算等高多层超低损 PCB 已实现量产，目前已经实现了 28 层高多层板、4 阶 24 层 HDI（包括任意层互连）、6oz 厚铜多层板、多层软板、多层 HDI 软硬结合板的批量生产能力。公司在高多层 PCB 制作中应用精密层间对位偏差管控、高频信号特性阻抗控制、高频信号损耗控制，高精度背钻，耐高压等技术。上述技术在改善产品质量、提升产品标准方面发挥着重要的作用。

另外，公司近年来也不断加大技术研发投入，截至 2024 年 12 月 31 日，公司共获国家 138 项专利。2019 年，公司“通讯设备专用高精密、高集成多层电

路板工程技术研究中心”被认定为省级工程技术研发中心；2019 年，公司与广东省科学院达成战略合作伙伴，在公司建立“广东省科学院企业工作站”，双方将在 PCB 先进封装工艺技术、LED 高清封装载板技术、基于智能嵌入式互联技术的 PCB 产品等方面开展产学研合作；2022 年公司（多层板、HDI）项目入选国家工信部发布的符合《印制电路板行业规范条件》企业名单；2023 年入选广东省制造业单项冠军及广东省企业技术中心公司深厚的技术储备为项目的顺利实施提供了保障。

3、丰富的生产经验和完善的质控体系为项目顺利实施奠定基础

经过多年的发展与沉淀，公司积累了先进的生产技术和丰富的生产经验。通过大量的试验探索和生产实践，目前公司已形成了一整套完善的生产管理和产品质量控制体系。为了满足客户对产品质量的严格要求，公司不断追求品质提升，先后通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485、ISO45001 等相关体系认证，建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系。

近年来，公司持续对工厂进行自动化、智能化生产改造，引进 SCADA 生产实时管理系统，收集生产过程中产品的产量、品质、设备、能耗、6M 等数据，对生产过程进行防错、监控、实时分析和售后追踪；并在部分车间建成激光刻二维码追溯系统，利用 X-ray 穿透识别和 OCR 钻孔明码识别结合，简化钻孔流程追溯码关联到外层追溯码，在产品可追溯及生产在线管理方面获得了显著提升。本项目将在公司现有基础上进一步完善生产和质量管理体系，提高产品质量稳定性和客户满意度。

4、优质的客户资源为项目实施提供有利条件

经过多年的市场拓展和品牌建设，公司凭借良好的产品质量，树立了良好的品牌形象，同时积累了大量优质稳定的客户资源，销售收入实现稳步增长。目前，公司已进入特斯拉（Tesla）、松下（Panasonic）、三菱（Mitsubishi）、博世（Bosch）、戴森（Dyson）、新思（Synaptics）、雅培（Abbott）、银体特（Insulet）等一大批国际知名企业的供应商体系，成为了上述企业重要的 PCB 供应商。公司现阶段具备量产能力的产品包括单、双面板、多层板、Anylayer 任意互联 HDI、软板、软硬板（HDI 软硬板）、半柔板（Semi-flex）、汽车用高散热铝基/铜基板等，丰富的产品体系不仅有助于公司拓展多个下游应用领域，也有利于深化与现有客

户的合作，挖掘其潜在需求，为本项目产品的销售提供了良好条件。

（三）经济效益分析

经预测分析，新项目达产后将实现年销售收入 71,964.00 万元，净利润 7,980.54 万元。本项目财务内部收益率与投资回收期均处于正常水平，各项经济效益指标合理，均符合国家有关规定及投资方要求，在经济效益方面是切实可行的。

五、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

印制电路板作为电子信息产业的基础行业，印制电路板行业产业规模巨大。2023 年 PCB 行业受到去库存压力的影响，行业产值出现了下滑，随着市场库存积压、终端消费电子需求疲软等问题进入尾声阶段，以及下游 AI 应用需求爆发，PCB 逐渐进入新的增长周期。根据 Prismark 数据显示，2024 年，全球 PCB 总产值为 735.65 亿美元，同比增长 5.8%，预计 2029 年全球 PCB 产值有望达到 946.61 亿美元的水平，2024-2029 年复合增速预计将达到 5.2%，行业总体将呈现稳定增长的态势。

PCB 不同下游领域市场增速差异较大。新能源和人工智能 AI 是未来行业增长的主要动力。

随着新能源汽车的推进和智能驾驶的进阶，汽车用 PCB 持续稳步发展，目前车用 PCB 以 2-8 层板为主，随着自动驾驶等级和渗透率持续提升，平均每车配备的镜头及雷达等电子产品数量也将不断增加。智能驾驶系统多采用单价较高的 HDI 板（高密度互连），其价格约为目前主采用 4-8 层板的 3 倍。而先进驾驶员辅助系统（ADAS）或自动驾驶功能 L3 以上自驾系统配备的 LIDAR（激光雷达）所采用的 HDI 价格可达数十美元，这也是未来车用 PCB 产值增量的主要来源。

人工智能的快速发展需要大量的高性能计算（HPC）算力支持，对 AI 服务器需求提升，继而推动 PCB 的发展，PCB 也从普通的多层板（如：12 层）升级到高多层（如：24 层）或 HDI 板，对比普通服务器和以 NVIDIA DGX A100 为代表的 AI 服务器，AI 服务器所用 PCB 单机价值量相对普通服务器提升 532%，

增量贡献主要来自算力需求(贡献增量的 95%)和集中度提升(贡献增量的 5%),其中载板级的单机价值量提升 490%、增量贡献主要来自算力需求(贡献增量 100%), PCB 板级的单机价值量提升 580%、增量贡献 90%来自算力而 10%来自集中度提升。根据 Prismark 数据, 2023 年全球服务器及相关系统组件的 PCB 市场规模约为 51.77 亿美元, 预计该数字将在 2028 年达到 79.74 亿美元, 增速达到 9%。

(二) 新项目可能存在的风险

1、市场竞争风险

全球 PCB 行业已实现完全竞争。虽然目前行业领先企业具有较为明显的综合竞争优势, 在客户、规模、研发、技术、质量、成本控制等方面均处于行业领先地位。但由于中国国内从事 PCB 生产的企业较多, 且部分企业成长较快, 竞争力日益增强。未来中国 PCB 生产企业面临的市场竞争可能进一步加剧。在此背景下, 如果公司不能及时研发出适应技术发展和客户需求的产品, 可能面临失去订单或客户的风险, 从而对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

2、下游市场需求波动风险

如若未来本项目产品深度绑定的新能源汽车、数据中心行业以及集成电路市场需求不及预期, 则会影响本项目产品销售, 导致项目产能消化面临一定困难, 进一步影响预期经济效益的实现。

同时, 新能源汽车、AI 技术和机器人也衍生了不同类型的 PCB 需求, 然而国际局势动荡、利率的大幅浮动和欧美各国的通胀压力等等因素会影响市场的消费信心, 从而负面影响到市场的需求。

3、原材料价格波动风险

原材料采购价格的变化是导致企业毛利率波动的重要因素。PCB 生产企业采购的主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、金盐、干膜、半固化片和油墨等。其中覆铜板、铜箔、铜球价格主要受国际大宗商品金属价格的影响。印制电路板是 PCB 产业链的最终产品, 受上游原材料价格涨跌的影响比较大。其中铜占 PCB 生产企业生产成本较高, 作为国际性的重要工业原材料, 影响铜价格的因素还有很多, 但是基本上都可以归类为两个主要因素: 一是宏观经济状况, 二是供需关

系。无论是库存、利率、还是原油价格波动、汇率变化等引起的铜价波动，都可以被划分到这两个方面之内。

如果未来原材料的价格出现大幅波动，而 PCB 生产企业不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，将会对经营成果产生不利影响。

4、产品质量风险

本公司为电子产品制造厂商供应其重要部件之一印制电路板，产品质量是公司的安身立命之本。产品质量事故所造成的影响和损害将对公司带来严重的不良影响。尽管公司拥有完善的质量控制规程，但仍不能完全杜绝因控制失误、责任人疏忽、过程衔接有误等因素，导致公司产品质量受影响的情形出现。

（三）风险控制措施

1、针对市场竞争风险的措施

作为印制电路板领先企业，公司深刻理解行业特点与需求，针对市场竞争风险，将继续强化其研发技术优势，使产品更加贴近客户需求，提高产品的适销性，并实现品牌形象的塑造与强化。同时，生产部门将继续提高产品品质，确保产品持续为目标市场所认可。此外，公司可以借助现有的客户资源，保证产品研发设计、生产加工及销售三大环节的贯通，增强其市场渗透力，提高企业的市场竞争能力。

2、针对下游市场需求波动风险的措施

针对下游市场需求波动风险，公司将进一步深化市场分析和预测，与客户保持密切沟通，及时了解市场动态。与此同时，公司还将完善产品结构，丰富产品体系，充分利用产能，以抵抗下游市场需求波动给公司产品销售带来的影响。

3、针对原材料价格波动风险的措施

公司采取战略性备料方式，当市场原材料价格波动较大时，依订单需求分批进料的方式，以达到减少材料库存量，降低采购成本。此外，公司每年初都会依据当年市场预测订单情况，设定采购任务及采购目标，并制定相应的材料成本控制目标。公司采取集团化采购模式，每年开发能和公司共同成长的战略合作伙伴作为长期供应商，具有较强的议价能力，减少因为原材料价格波动带来的风险。

4、针对产品质量风险的措施

公司将从品质部门建设、质检设备的更新、质量控制及质量检测程序的优化等各环节，提高公司产品的安全可靠性及有效性。同时，公司将持续加强一线生产人员、品质检测人员的责任心，从根本上杜绝质量事故的发生，使产品在行业内保持良好口碑，进一步增强公司的商业信誉和品牌效应，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

针对上述风险，公司将密切关注新项目的实施进展，强化对新项目的跟踪和管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、有关部门审批的情况

公司已办理完成境外投资设立泰国世运的备案登记事宜，并先后收到广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开发函〔2024〕970号）、广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400202400495号），并已在主管银行办理外汇登记手续。

2024年6月，泰国世运与泰国高峰绿色工业园已经签署《土地购销协议》，购买土地面积约109.75875莱（折合175,614.00平方米），购买价格为439,035,000.00泰铢。

七、募集资金保障措施

公司拟新增的募投项目实施主体为全资子公司泰国世运，实施地点为境外。公司及保荐机构将采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，具体如下：

1、公司及子公司拟新设募集资金专户，并将与保荐机构及开户银行按规定签订《募集资金监管协议》，共同对募集资金实施专户管理。

2、本次新增募集资金开户银行将选择中资银行，保证账户资金安全性及监管措施实施到位。

3、募集资金支付银行会每笔审核支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，

确认印鉴、资金用途是否与约定一致，保证资金使用规范性。

4、保荐机构将采取包括但不限于定期获取银行账户对账单、对大额支出进行抽查查验、至少每半年度进行一次募集资金现场检查等方式对募集资金的日常使用进行监管。

5、公司将在以后的年度及半年度《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中披露相关具体措施和实际效果。

八、审议程序

本次部分募投项目变更及部分募投项目延期事项已经公司召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目变更及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次部分募集资金投资项目变更事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次部分募投项目变更及部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司
变更部分募投项目及部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王笑雨



于云德

